

Title (en)
SELECTIVE PROCESS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD MANUFACTURING.

Title (de)
SELEKTIVES VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG GEDRUCKTER LEITERPLATTEN.

Title (fr)
PROCEDE SELECTIF DE FABRICATION DE CARTES A CIRCUITS IMPRIMES.

Publication
EP 0570432 A1 19931124 (EN)

Application
EP 92903944 A 19920210

Priority
US 65334291 A 19910208

Abstract (en)
[origin: US5250105A] A new family of palladium based metallization catalyst compositions is disclosed. These catalysts are used in a process for the selective deposition of a metal on a substrate when a metallization mask (i.e. a plating resist) is used over the substrate. Processes and compositions are also disclosed for manufacturing printed circuit boards, by using two metallization sequences, or one alone the latter comprising a so-called "selective process." The process and composition are generally employed for the electroless plating of substrates, namely the metallization of plastics, ceramics, anodized aluminum and other materials.

Abstract (fr)
Nouvelle famille de compositions catalytiques de métallisation à base de palladium. Ces catalyseurs sont utilisés dans un procédé de dépôt sélectif d'un métal ou d'un substrat lorsqu'un masque de métallisation (c'est-à-dire un vernis photosensible) est utilisé sur le substrat. Sont également visés des procédés et des compositions pour la fabrication de cartes à circuits imprimés basés sur deux phases de métallisation ou sur une seule, la seconde formule faisant appel audit procédé "sélectif". Le procédé et la composition sont généralement employés pour le dépôt sans courant sur les substrats, spécialement la métallisation des plastiques, des céramiques, de l'aluminium anodisé et d'autres matériaux.

IPC 1-7
C23C 18/30; **C23C 18/28**

IPC 8 full level
C23C 18/28 (2006.01); **C23C 18/30** (2006.01); **C23C 18/31** (2006.01); **C23C 18/34** (2006.01); **C25D 7/00** (2006.01); **H05K 3/18** (2006.01); **H05K 3/42** (2006.01)

CPC (source: EP US)
C23C 18/28 (2013.01 - EP US); **C23C 18/30** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
See references of WO 9213981A2

Designated contracting state (EPC)
AT DE ES FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9213981 A2 19920820; **WO 9213981 A3 19921126**; EP 0570432 A1 19931124; JP H06505770 A 19940630; US 5250105 A 19931005

DOCDB simple family (application)
EP 9200282 W 19920210; EP 92903944 A 19920210; JP 50396292 A 19920210; US 65334291 A 19910208